

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2026-021

## **合肥晶合集成电路股份有限公司**

### **关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售等事宜的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025 年 9 月 29 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司于 2026 年 3 月 31 日重新向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 30 日、2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晶合集成关于向香港联交所递交 H 股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-062）、《晶合集成关于重新向香港联交所递交 H 股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-008）。

2026 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1134 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晶合集成关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-014）。

2026 年 6 月 4 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。

2026年6月8日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站披露的《晶合集成关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-018）。

2026年6月30日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使A股投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：

中文：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0630/2026063000124\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0630/2026063000124_c.pdf)

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0630/2026063000123.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股及上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股基础发行股数为216,167,000股（最终发行股数视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售21,616,700股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售194,550,300股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。

自上市日起至香港公开发售截止日后起 30 日内，保荐人兼整体协调人（代表国际包销商）可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过 32,425,000 股 H 股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 248,592,000 股。

公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 32.30 港元。公司 H 股香港公开发售于 2026 年 6 月 30 日开始，预计于 2026 年 7 月 7 日结束，并预计于 2026 年 7 月 9 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和公司网站（[www.nexchip.com.cn](http://www.nexchip.com.cn)）

公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 7 月 10 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日